

Objekttyp: **Miscellaneous**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **133 (2007)**

Heft 13: **Schwingungen**

PDF erstellt am: **11.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## GLÄNZEND

Thermopal hat bei Hochglanzdekoren im Uni-bereich mit dem neuen Sortiment eine verbesserte Produktqualität hinsichtlich Brillanz, Langlebigkeit und Ausführung erreicht: Die Postforming-Elemente beeindrucken mit optimierter Oberflächenruhe.

Bisher war es schwierig, stark hochglänzende HPL-Verbundplatten herzustellen. Gerade bei Uni-Dekoren zeigte sich unter bestimmten Lichtverhältnissen ein unruhiges Erscheinungsbild der Glanzoberfläche. Die neue Produktionsanlage von Thermopal beseitigt dieses Problem, indem sie mit so genanntem PUR-Hotmelts arbeitet. Dieser Klebstoff verbindet in zwei Phasen Träger und Dekor dauerhaft und erzeugt dabei eine noch bessere Oberflächenruhe. So wird auf Brillant-HPL-Verbundplatten ein einzigartiger Glanz ohne Unebenheiten möglich.

In diesem Zusammenhang präsentiert Thermopal der Küchen- und Möbelindustrie eine spezielle Auswahl an Trendfarben in Hochglanz: Neben dem kräftigen Grünton «Iguana» stehen mit «Edelweiss» und «Elfenbein» sanfte Weisstöne ebenso zur Auswahl wie warme Beigetöne der bereits bekannten Caffè-Latte-Serie. Ebenfalls im Programm sind Klassiker des Uni-bereichs, darunter der Rotton «Bordeaux» oder das dunkle Anthrazit «Vulkanit». Weitere Dekore sind auf Anfrage lieferbar. Hinsichtlich der Radien bietet Thermopal dank der neuen Anlage seine Hochglanz-Postforming-Elemente zudem im engen Radius von 3 mm an.

Thermopal GmbH | D-70372 Stuttgart  
www.thermopal.com

## PFLEGELEICHT

Armstrong hat den Bodenbelag Linoleum aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen mit einem «PUR-Eco-System» versehen: Anstelle der herkömmlichen zweifachen, wasserbasierenden Acrylwachsschicht wird bei Armstrong «DLW Linoleum PUR» eine einfache Schicht aus unverdünntem, UV-gehärtetem Polyurethan aufgebracht. Damit vereint «Linoleum PUR» erstmals die beiden entscheidenden Vorteile elastischer Bodenbeläge: Kosteneffizienz und Umweltfreundlichkeit. Alle 60 Farben der Struktur Marmorette sind inzwischen mit dem neuen «PUR-Eco-System» erhältlich, zusätzlich zum Linoleum-Standortsortiment. Die dazu passende Fugenabdichtung «Palmwaxdraht» ist ebenfalls in allen Farben lieferbar.

Das neue Linoleum ist besonders emissionsarm und geruchsneutral. Nach der Verlegung ist keine Einpflege mehr notwendig, der Boden kann also sofort genutzt werden. Die dauerhafte Reinigung erfolgt mit einem Alkohol- bzw. Neutralreiniger, der deutlich preiswerter ist als gewöhnliche Wischpflegemittel. Durch die neue Oberflächenvergütung und einfachere Reinigung sinken die Reinigungskosten gegenüber herkömmlichem Linoleum dauerhaft bis zu 30%. Das «PUR-Eco-System» verbessert zudem die Nachhaltigkeit von Linoleum spürbar: Weniger Wasserverbrauch und geringerer Reinigungsmiteinsatz bedeuten eine geminderte Umweltbelastung. So kann der ökologische Bodenbelag Linoleum eine echte Alternative zu PVC-Belägen werden.

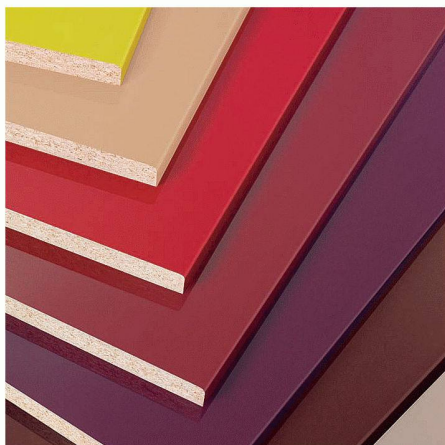
Armstrong DLW (Switzerland) AG | 8048 Zürich  
www.armstrong.com

## VORGEFERTIGT

Mit dem Verbundsystem «Wey-Pi» hat die Firma Wey Modulbau ein Konstruktionselement entwickelt, das die Vorteile des Holz-Beton-Verbundes und der Vorfertigung kostengünstig verbindet. Mit der Anpassung der Bauverordnung stellen sich für den Holzbauer höhere Anforderungen hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Tragfähigkeit, die mit herkömmlichen Holzkonstruktionen nicht oder nur mit hohem Aufwand erfüllbar sind. Holz-Beton-Verbundkonstruktionen können – verglichen mit reinen Holzkonstruktionen – höhere Anforderungen erfüllen, weil der Verbund dieser Materialien höhere Steifigkeiten, besseres Schwingungsverhalten sowie besseren Schall- und Brandschutz ermöglicht.

Das neue «Wey-Pi»-Deckenelement besteht aus einer bewehrten Betonplatte mit Gitterträgern und Brettschicht-Holzrippen, die zu einer statischen Einheit (schubfest) als Rippenplatte oder Kastenträger verbunden werden. Das Verbundsystem eignet sich für Geschoss- und Zwischengeschossdecken von Wohn-, Industrie- und Gewerbebauten sowie für die Konstruktion von Attikageschossen und Schrägdächern. Die Systemelemente – in Breiten von 62.5 bis 300 cm und Länge bis 1600 cm erhältlich – sind auf Wunsch auch als Halbfabrikate mit bereits montierter Deckenverkleidung lieferbar. «Wey-Pi»-Elemente sind eine Konstruktion aus bekannten, erprobten und kostengünstigen Teilen und stehen dem Holzbauer als vorgefertigte Bauteile zur Verfügung.

Wey Modulbau AG | 5612 Villmergen  
www.weyag.ch



### PRODUKTHINWEISE

Auf den Abdruck von Produkthinweisen besteht kein Anspruch. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Bitte senden Sie uns Ihre Produktinformationen an Redaktion TEC21, Postfach 1267, 8021 Zürich, oder an [produkte@tec21.ch](mailto:produkte@tec21.ch)

# yes!

by  ivbh.ch

YOUNG ENGINEERS'  
SYMPOSIUM 2007

**CALL FOR PAPERS  
VERLÄNGERT  
bis 13. April 2007**

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND ARCHITEKTUR – FREIBURG  
**31. MAI 2007**

## 2. Symposium der IVBH Schweiz mit Wettbewerb für junge Bauingenieure

- **Präsentationsplattform** für junge Bauingenieure aus dem konstruktiven Ingenieurbau
- **Vorträge** im Plenum und Postersession mit Kurzpräsentationen
- **Auszeichnungen / Preise** für die besten Vorträge und Poster
- **Keynote** von Toni «El Suizo» Rüttimann
- **Junge Ingenieure** präsentieren das eigene Tun und knüpfen neue Kontakte.
- **Erfahrene Ingenieure** lernen ihre jungen Kollegen und deren Potenzial kennen.
- **Jetzt anmelden und Paper bis 13.4.2007 einreichen!**
- **Gute Gründe und alle Infos unter: [www.ivbh.ch/yes](http://www.ivbh.ch/yes)**

### Gute Gründe gibt's genug:



**Rahel Nissille**  
(Posterautorin YES-06)

Ich will zeigen, was ich als Berufseinsteigerin schon geleistet habe.



**Michel Thomann**  
(Sieger YES-06)

Am YES interessiert mich, was andere junge Bauingenieure machen.



**Dr. Ann Schumacher**  
(Jury-Mitglied YES-07)

Am YES sehe ich einen Querschnitt durch das Wirken junger Berufskollegen.



**Werner Bachmann**  
(Überzeugter YES-Teilnehmer)

Ich schicke meine jungen Mitarbeiter ans YES, weil ich sie gezielt fördern will.

#### ADRESSE DER REDAKTION

TEC21  
Staffelstrasse 12, Postfach 1267  
8021 Zürich  
Telefon 044 288 90 60, Fax 044 288 90 70  
E-Mail [tec21@tec21.ch](mailto:tec21@tec21.ch)

**WWW.TEC21.CH**

#### REDAKTION

Lilian Pfaff (lp), Chefredaktion  
Ivo Bosch (ib), Wettbewerbe/Architektur  
Claudia Carle (cc), Umwelt/Energie  
Nathalie Cajacob (nc), Redaktionsassistentin  
Katrika Corts (co), Architektur/Ingenieurwesen  
Daniela Dietsche (dd), Ingenieurwesen/Verkehr  
Rahel Hartmann Schweizer (rhs), Architektur/Städtebau  
Clementine Hegner-van Rooden (cvr), Ingenieurwesen/Statik  
Katharina Moschinger (km), Abschlussredaktion  
Aldo Rota (ar), Bautechnik/Werkstoffe  
Anna Röthlisberger (Stampfli Publikationen AG), Layout  
Ruedi Weidmann (rw), Baugeschichte

Die Redaktionsmitglieder sind direkt erreichbar unter:  
[Familienname@tec21.ch](mailto:Familienname@tec21.ch)

#### REDAKTION SIA-INFORMATIONEN

Generalsekretariat SIA  
Selnastrasse 16, Postfach 1884, 8027 Zürich  
Telefon 044 283 15 15, Fax 044 283 15 16  
E-Mail [contact@sia.ch](mailto:contact@sia.ch)  
Thomas Müller (tm)  
Peter P. Schmid (pps)  
Normen Telefon 061 467 85 74  
Normen Fax 061 467 85 76

#### HERAUSGEBERIN

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine /  
SEATU Société des éditions des associations techniques universitaires  
Mainaustrasse 35, 8008 Zürich  
Telefon 044 380 21 55, Fax 044 388 99 81  
E-Mail [seatu@smile.ch](mailto:seatu@smile.ch)  
Rita Schiess, Verlagsleitung  
Hedi Knöpfel, Assistenz

Erscheint wöchentlich, 42 Ausgaben pro Jahr  
ISSN-Nr. 1424-800X  
133. Jahrgang

Nachdruck von Bild und Text, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion und mit genauer Quellenangabe.  
Für unverlangt eingesandte Beiträge haftet die Redaktion nicht.

Auflage: 10940 (WEMF-beglaubigt)

#### ABONNEMENTSPREISE

Jahresabonnement (42 Ausgaben)  
Schweiz: Fr. 275.– | Ausland: Fr. 360.– | Euro 232.–  
Studierende CH: Fr. 138.– | Studierende Ausland: Fr. 223.– | Euro 144.–  
Halbjahresabonnement (21 Ausgaben)  
Schweiz: Fr. 153.– | Ausland: Fr. 195.50 | Euro 126.–  
Studierende CH: Fr. 76.– | Studierende Ausland: Fr. 118.50 | Euro 76.–  
Schnupperabonnement (8 Ausgaben)  
Schweiz: Fr. 20.– | Ausland: Fr. 32.– | Euro 21.–

Ermässigte Abonnemente für Mitglieder BSA, Usic und ETH Alumni.  
Weitere auf Anfrage, Telefon 031 300 63 44

#### ABONNENTENDIENST

Stampfli Publikationen AG  
Postfach 8326  
3001 Bern  
Telefon 031 300 63 44, Fax 031 300 63 90  
E-Mail [abonnemente@stampfli.com](mailto:abonnemente@stampfli.com)

Adressänderung für SIA-Mitglieder:  
[mufaktion@sia.ch](mailto:mufaktion@sia.ch)

#### EINZELBESTELLUNGEN

Einzelnummer (Bezug beim Abonentendienst)  
Fr. 12.– | Euro 8.– (ohne Porto)

#### INSERATE

KünzlerBachmann Medien AG  
Postfach, 9001 St. Gallen  
Telefon 071 226 92 92, Fax 071 226 92 93  
E-Mail [info@kbmedien.ch](mailto:info@kbmedien.ch)  
[www.kbmedien.ch](http://www.kbmedien.ch)

#### DRUCK

Stampfli Publikationen AG, Bern

#### GESTALTUNGSKONZEPT

Integral Ruedi Baur, Zürich | Claudia Wildermuth

#### BEIRAT

Hans-Georg Bächtold, Liestal, Raumplanung  
Heinrich Figli, Chur, Bauingenieurwesen  
Markus Friedli, Frauenfeld, Architektur  
Erwin Hepperle, Bubikon, öff. Recht  
Roland Hühlimann, Zürich, Baurecht  
Daniel Meyer, Zürich, Bauingenieurwesen  
Ákos Morávanszky, Zürich, Architekturtheorie  
Ulrich Pfammatter, Burgdorf, Technikgeschichte  
Franz Romero, Zürich, Architektur

#### TRÄGERVEREINE

**Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, SIA**  
[www.sia.ch](http://www.sia.ch)

**TEC21** ist das offizielle Publikationsorgan des SIA.  
Die Fachbeiträge sind Publikationen und Positionen der Autoren und der Redaktion.  
Die Mittelungen des SIA befinden sich jeweils in der Rubrik «SIA».

**Schweizerische Vereinigung  
Beratender Ingenieur-Unternehmungen, usic**  
[www.usic-engineers.ch](http://www.usic-engineers.ch)

**Das Netzwerk der Absolventinnen  
und Absolventen der ETH Zürich, ETH-Alumni**  
[www.alumni.ethz.ch](http://www.alumni.ethz.ch)

**Bund Schweizer Architekten, BSA**  
[www.architekten-bsa.ch](http://www.architekten-bsa.ch)

**Association des diplômés de l'EPFL**  
<http://a3.epfl.ch>



**STUHL HAUS STADT – HAEFELI MOSER STEIGER**

Die Architektengemeinschaft Haefeli Moser Steiger gehört zu den bedeutendsten Schweizer Architekturbüros des 20. Jahrhunderts. Ihr umfassender Gestaltungsanspruch reichte vom Möbel- und Ausstellungsdesign über das Einzelgebäude und die Siedlung bis zur Stadt- und Landesplanung. Die Ausstellung ist eine Koproduktion des Museums für Gestaltung Zürich und des Instituts gta der ETH Zürich.

Datum: 30.3.–1.7.07  
 Ort: Museum für Gestaltung, Zürich  
 Infos: [www.museum-gestaltung.ch](http://www.museum-gestaltung.ch)

Hochhaus zur Palme, Zürich (Bild: Georg Aerni, 2006)

**ANLASS**

**DETAILS**

**INFOS/ANMELDUNG**

**VORTRAGSREIHE**  
 «Ein Haus von...»

Vier Bündner Architekturbüros stellen ihre architektonische Haltung an einem für ihr Schaffen exemplarischen Gebäude dar. Den Anfang machen Mierla und Kurt Lazzarini mit dem Projekt «Wohnüberbauung Giardin, Samedan»

3.4.07 | 18.15–19.15h  
 Sennareal, Basel  
 Infos: [www.fhnw.ch/habg/iarch](http://www.fhnw.ch/habg/iarch)

**FORUM**  
 «Stadt und Dichte – ein Synonym?»

Im europäischen Kulturraum ist Dichte ein qualitativer Begriff. Dichte und Komplexität sind Voraussetzungen für eine urbane Atmosphäre und Qualität. Welche Bedingungen ergeben sich daraus für den Entwurf von Stadtarchitektur?

3.4.07 | 18.30h  
 Kornhausforum Bern  
 Infos: [www.architekturforum-bern.ch](http://www.architekturforum-bern.ch)

**INFOABEND**  
 «Bauingenieur, Bauingenieurin – ein Beruf mit Perspektive»

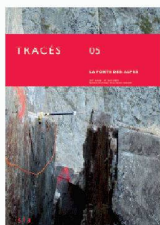
Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil informiert über den Beruf sowie über den Studiengang Bauingenieurwesen. Der nächste Studiengang ist im September 2007

3./25.4.07 | 18.40–20.10h  
 HSR, Rapperswil  
 Infos: [www.hsr.ch](http://www.hsr.ch), Tel. 055 222 49 27

**SEMINAR**  
 «Materialbewirtschaftung auf Baustellen»

Erfahrungen bei der Wiederverwertung verschiedener Baumaterialien wie Tunnelaushub, Betonrecycling, Verwertung von Asphalt und Bitumen bei Strassensanierungen. Stand der Dinge, Methoden, Beispiele, Erfahrungsaustausch

27.4.07 | 9–17h  
 Swisscom Conference Center Olten  
 Anmeldung bis 10.4. erforderlich: [www.sanu.ch/angebot07](http://www.sanu.ch/angebot07)



**TRACÉS 05**  
 21.3.07  
**LA FONTE DES ALPES**

Bulletin technique de la Suisse romande  
 Rue de Bassenges 4  
 1024 Ecublens  
 Tél. 021 693 20 98  
 Fax 021 693 20 84  
 E-mail secrétariat:  
[fdc@revue-traces.ch](mailto:fdc@revue-traces.ch)  
[www.revue-traces.ch](http://www.revue-traces.ch)



**VORSCHAU NR. 14**  
 2.4.07  
**IMPLANTATE**  
 Transplantierte Körperlichkeit  
 Rahel Hartmann Schweizer  
 Implantierte Urbanität  
 Hansjörg Gadiant  
 Setzling im Dorf  
 Christian Holl

**TEC21-ABO BESTELLEN:**  
**TEL. 031 300 63 44 ODER**  
**WWW.TEC21.CH**